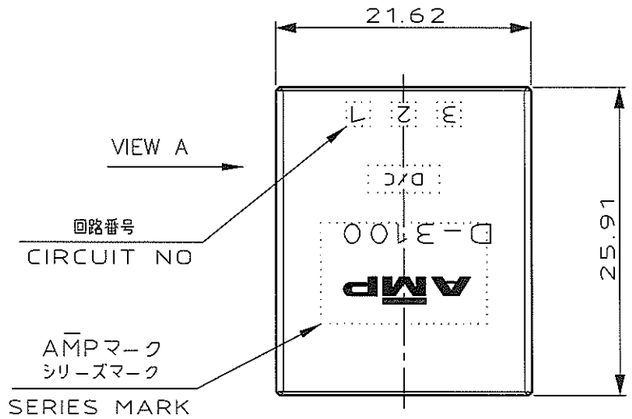
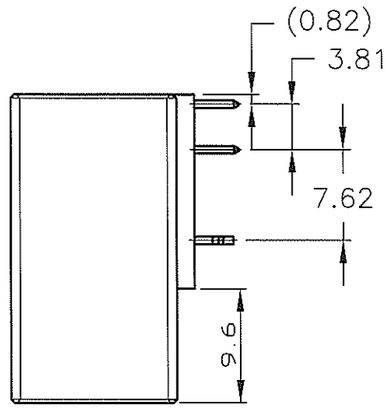
NUMBER 178303

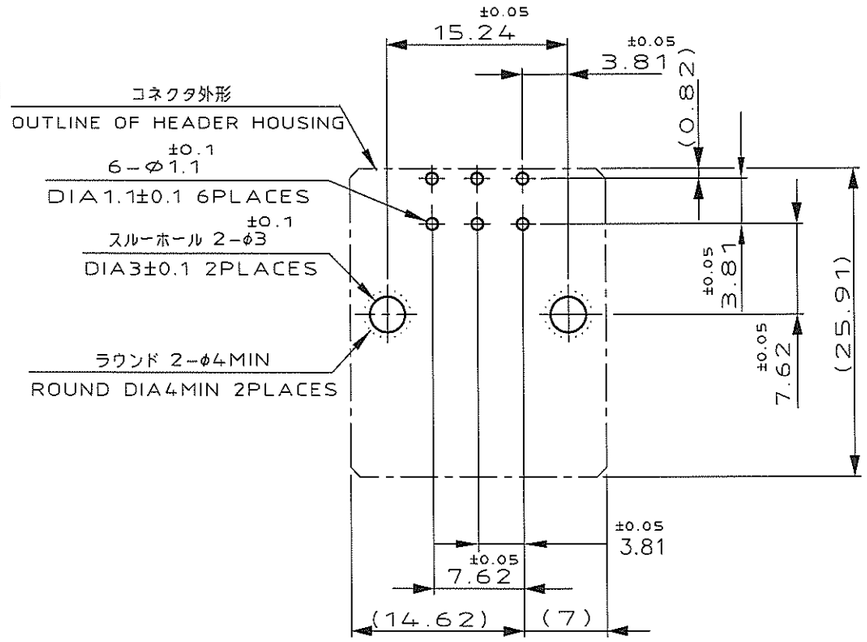
3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT



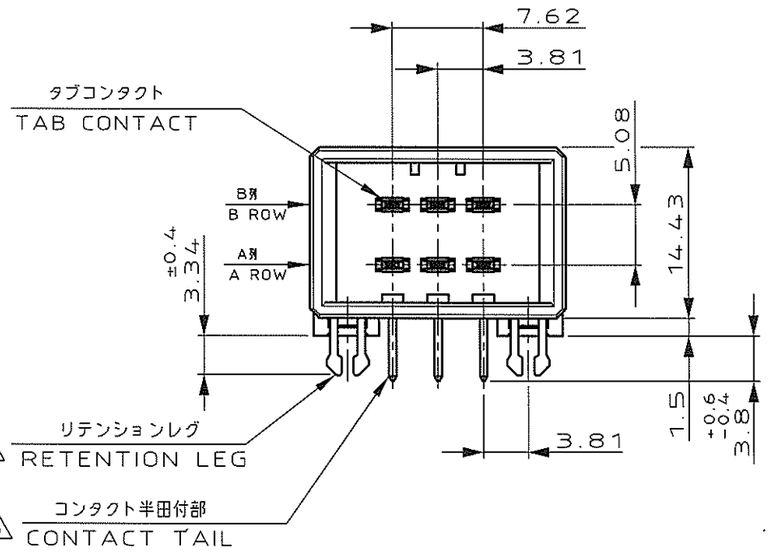


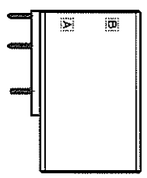


推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚：1.6±0.1
（非累積公差）
（コネクタ搭載面）

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)





VIEW A
(SCALE:1:1)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
~~5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト：銅合金
リテンションレグ：銅合金
2. めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：0.38μm MIN金めっき
3. めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：0.76μm MIN金めっき
4. めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：2.0 μm MINスズめっき
~~5. めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部 ：ニッケル下地の上に半田めっき~~
6. めっき リテンションレグとコンタクト半田付部 ：ニッケル下地の上にスズめっき

6 4	178303-5	
6 3	178303-3	
6 2	178303-2	
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
C1	REVISED ECR-07-013273	TS	DM	11 JUN 2007
C	REVISED(FJD0-0039-03)	TS	S.M	6/2 '03
B	REVISED(FJD0-0097-03)	TS	S.M	4/15 '03
A	REVISED(FJ00-2183-95)	KI	SM	3-23 '95
0	RELEASED (J-1184)	NM	H.O S.M	3-4 '92

Copyright © 1991
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K
Kawasaki,Japan

WIRE RANGE	mm²(AWG -)
INSULATION DIA	- mmφ
MATERIAL	SEE NOTE 注記参照
FINISH	SEE NOTE 注記参照
DR.	14 JUN 91 N.Matsubara
DE.	14 JUN 91 N.Matsubara
CHK.	24/FEB/'92 H.Obata
APP.	4/MAR/'92 S.MANABE

NAME ダイナミック D3100 水平タイプ
6 極 ヘッダーアセンブリー
6 POS DOUBLE ROW
HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ±0.3
10を超え 30以下 ±0.4
30を超え100以下 ±0.45
角度 ±3°

SIZE	LOC	NUMBER
A3	J	C-178303

SCALE	REV.	SHEET
2-1	C1	1 OF 1

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面